

**平成21年6月22日投稿規程改訂版**  
**第26回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム**  
**応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会主催**  
**新設「集積化 MEMS シンポジウム」開催案内**

【開催主旨と案内】

応用物理学会では平成20年5月に集積化 MEMS 技術研究会を設立しました。その目的は、MEMS と LSI 両技術分野の融合により国内の産業および学術の活性化に貢献することです。また、各学会との連携を図り、広く人的ネットワークの裾野を広げ、産業界、大学含めた連携の基盤づくりを目指したいと考えています。今回、電気学会、機械学会との連携を深めるためにシンポジウムに参加を目的とした新設「集積化 MEMS シンポジウム」のご案内をいたします。

これまで、電気学会ではセンサ・マイクロマシン部門において、「センサ・マイクロマシンと応用システム」と題してシンポジウムを毎年開催し、学際的な領域にあるセンサ・MEMS 技術のさらなる発展を目指し、センサ・マイクロマシンに関して最新技術が発表されてきました。また、昨年は、日本機械学会マイクロ・ナノ工学専門会議の参加により「機械工学合同セッション」を設け、学会の連携が始まったところです。このような背景のもと、本研究会が「集積化 MEMS シンポジウム」を新設し参加することにより、広く LSI 技術と MEMS 技術の交流の機会を設けたいと思っています。「真の集積化」に向けて従来の学会の枠を超えた議論ができればと考えています。

今回、MEMS 技術が More than Moore の解の一つと期待される中、招待講演として、「More than Moore と MEMS」と題して、河村誠一郎氏にご講演いただく予定です。

つきましては、みなさまの参加と投稿をお願い申し上げます。なお、参考のために、下記 HP にシンポジウム、各学会をご紹介しますので、是非ご覧になってください。

- ・ 昨年の第25回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

[http://www2.iece.or.jp/~smas/Sensor\\_Sympo/25/index.html](http://www2.iece.or.jp/~smas/Sensor_Sympo/25/index.html)

- ・ 応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会

<http://annex.jsap.or.jp/MEMS/>

- ・ 日本機械学会マイクロ・ナノ工学専門会議

<http://www.jsme.or.jp/mnm/index.html>

【会場】

東京 タワーホール船堀 アクセス

<http://www.towerhall.jp/4access/access.html>

【期間】

平成21年10月15(木)～16日(金)

【参加登録料】

- ・ 会員事前 25,000 円、会員当日 35,000 円、非会員事前 30,000 円、非会員当日 40,000 円、学生 10,000 円、懇親会費 5,000 円(予定)集積化 MEMS 技術研究会員又は応物会員は、会員扱いになります。
- ・ 参加ご希望の方は次の HP よりオンライン登録を行ってください。

<http://www.conferences.jp/26thSensorSymposium/>

【懇親会】

平成21年10月15日(木) 18:30 - 21:00

【集積化 MEMS シンポジウムの企画】

- i) 招待講演 「More than Moore と MEMS」 河村 誠一郎 氏 富士通
- ii) 一般講演 発表形式とポスター形式

- ・ 発表形式：講演時間 20 分(講演 15 分、質疑 5 分)。発表言語は日本語もしくは英語。
- ・ ポスター形式：電気学会、機械学会との合同ポスターセッションでの参加となります。ポスターセッションを希望する場合は申し込み用紙に記載願います。

参考：集積化 MEMS シンポジウムとは別に、電気学会、機械学会による招待講演、一般講演もあります。

【投稿方法】

- ・ 発表申し込み用紙(様式1)と発表概要1枚(A4 縦型用紙1ページに横書きで発表題目、所属、氏名、発表内容を日本語 1000 字程度あるいは英文 500 語程度、図および表使用可)を集積化 MEMS 技術研究会事務局にメールにて送付願います。[様式1は、こちら](#)。送付先 e-mail：[integMEMS2009@nano.pi.titech.ac.jp](mailto:integMEMS2009@nano.pi.titech.ac.jp)
- ・ 発表概要により審査し、発表がポスターについては平成 7 月 10 日頃にご連絡いたします。尚、6 月 2 日までの投稿規程に従い英文概要 1 枚を準備している場合は、それを発表概要にしてお申し込みください。その場合下記の英文概要 1 枚の提出は不要となりプロシーディングの提出のみとなります。

【投稿〆切】

平成21年6月8日(月) 7月3日(金)に延長しました。

【英文概要集用原稿とプロシーディング原稿の提出】

- ・ 英文概要集原稿(様式2)、刷り上りで1件当たり横書き A4 縦型用紙1ページ。[様式2は、こちら](#)。
- ・ 和文または英文による CD-ROM 版講演論文集の原稿(様式3)として、刷り上りで一件あたり横書き A4 縦型用紙4から6ページ。[様式3は、こちら\(和文\)](#)、又は[こちら\(英文\)](#)。平成21年8月28日(金)までに提出をお願いします。尚、英文概要集とプロシーディング論文はシンポジウム概要集、CD-ROM 講演論文集に合本されます。

【研究奨励賞、優秀論文賞、優秀ポスター賞】

研究会の規約([こちら](#))のもとに若手研究者、優秀な論文、ポスターを表彰します。

【問い合わせ先】

- ・ 集積化 MEMS シンポジウム担当委員 秦 誠一(東工大) [shata@pi.titech.ac.jp](mailto:shata@pi.titech.ac.jp)
- ・ 集積化 MEMS 技術研究会事務局 [integMEMS2009@nano.pi.titech.ac.jp](mailto:integMEMS2009@nano.pi.titech.ac.jp)